

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 5 月 21 日 (21.05.2004)

PCT

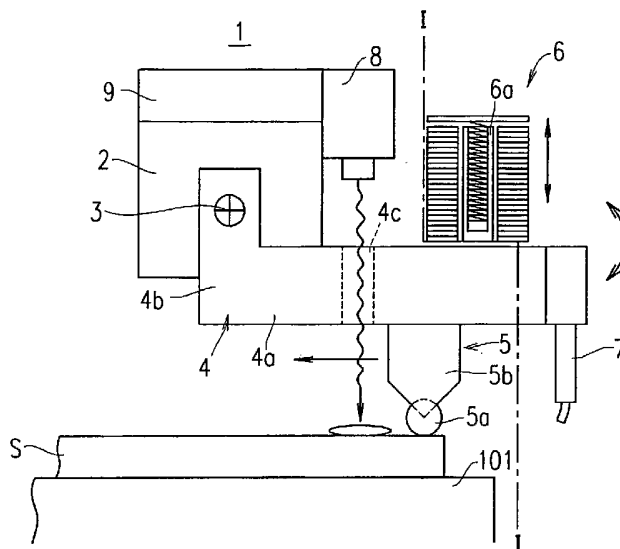
(10) 国際公開番号
WO 2004/041493 A1

- (51) 国際特許分類⁷: **B28D 5/00**, C03B 33/03, 33/023 (WAKAYAMA, Haruo) [JP/JP]; 〒564-0044 大阪府 吹田市 南金田二丁目12番12号 三星ダイヤモンド工業株式会社内 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/014080
- (22) 国際出願日: 2003 年 11 月 4 日 (04.11.2003) (74) 代理人: 山本 秀策, 外(YAMAMOTO, Shusaku et al.); 〒540-6015 大阪府 大阪市中央区城見一丁目 2-27、クリスタルタワー15階 Osaka (JP).
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2002-323112 2002 年 11 月 6 日 (06.11.2002) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三星ダイヤモンド工業株式会社 (MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒564-0044 大阪府 吹田市 南金田二丁目12番12号 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ユーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 若山 治雄

/ 続葉有 /

(54) Title: SCRIBE LINE FORMING DEVICE AND SCRIBE LINE FORMING METHOD

(54) 発明の名称: スクライブライン形成装置及びスクライブライン形成方法



(57) Abstract: A scribe line forming method, wherein the wheel tip (5a) of a glass cutter (5) is moved in contact with the surface of a fragile material substrate (S) with a load of such a degree that does not give a damage to the surface of the fragile material substrate (S), a vertical crack is produced on the fragile material substrate (S) at a specified position by an armature (6) which gives a sharp impact force to produce the vertical crack of a specified depth to the glass cutter (5) moving on the fragile substrate (S), and the vertical crack formed by the wheel tip (5a) of the glass cutter (5) is extended along a predicted scribe line by a stress gradient produced by a compressive stress produced in a radiated area where laser beam is radiated from a laser beam transmitter (8) on the fragile material substrate (S) to the vertical cracks and a tensile stress produced in a cooled area which is produced by a cooling medium jetted from a cooling nozzle (7) to form a scribe line.

/ 続葉有 /

WO 2004/041493 A1



FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:
— 国際調査報告書

(57) 要約: ガラスカッター5のホイールチップ5aを、脆性材料基板Sの表面上に損傷を与えない程度の荷重で接触しながら移動させ、この脆性基板S上を移動するガラスカッター5に対して所定深さの垂直クラックを発生させる急峻な衝撃力を与えるアマチュア6によって、脆性材料基板S上の所望の位置に垂直クラックを発生させる。この垂直クラックに対して、脆性材料基板S上におけるレーザ光発振器8からレーザ光が照射される照射領域に生じる圧縮応力と冷却ノズル7から放出される冷却媒体によって発生する冷却領域に生じる引張応力とにより発生する応力勾配によって、ガラスカッター5のホイールチップ5aによって形成された垂直クラックが、スクライプ予定ラインに沿って伸展させることによってスクライプラインを形成する。

明 細 書

スクライブライン形成装置及びスクライブライン形成方法

技術分野

- 5 本発明は、液晶ディスプレイ等に使用されるガラス基板等の脆性基板を分断するためのライン状のスクライブラインを形成するスクライブライン形成装置及びスクライブライン形成方法に関する。

背景技術

- 10 小型の情報端末、プロジェクションに適用可能な液晶ディスプレイは、情報処理技術の急速な進歩に伴うパソコン市場の拡大に伴って、そのニーズが幅広いものとなっており、今後の展開が期待されている。

- 特に、パソコン用、TV用の液晶ディスプレイにおいては、その表示画面を大型化、高精細化及び軽量化する要求が高まっており、この要求にあわせてガラス
15 基板の大寸法化及び薄板化が進められている。そして、ガラス基板の大寸法化及び薄板化に伴って、このようなガラス基板を所望の寸法に高精細に分断する高度な基板分断技術が要求されるようになっている。

- ガラス基板等の脆性基板は、ガラス基板の表面に所望の分断方向に沿ったライン状のスクライブラインを形成するスクライプ工程と、ガラス基板の表面上に形
20 成されたスクライブラインに沿った曲げモーメントをかけることによりガラス基板をスクライブラインに沿って分断するブレイク工程とを実行することにより分断される。

- ガラス基板にスクライブラインを形成するスクライプ工程では、垂直クラックのラインであるスクライブラインを、ガラス基板の表面に対して垂直下に深く浸
25 透させて形成することができれば、後のブレイク工程において、スクライブラインに沿って分断する際の分断精度を向上させることができるので、垂直クラック

を深く形成させることは重要である。

例えば、実開昭 5 9 - 8 8 4 2 9 号公報に示される様な手切りカッターを用いてカッターの先端に取り付けられたホイールチップをガラス基板の表面に加圧して転動させることによって、脆性材料基板の表面にスクライブラインを形成する
5 場合がある。また、複数の脆性材料基板の表面に、数多くのスクライブラインを連続して自動的に形成させる装置として、例えば、特開昭 5 5 - 1 1 6 6 3 5 号公報において開示されている装置を用いることが可能である。

ポイント式のダイヤモンドを用いてガラス基板の表面を切削することによりスクライブラインを形成する方法は、ガラス基板をポイント式のダイヤモンドで切削する過程でガラスの欠片（カレット）が必ず発生するので、液晶ディスプレイ
10 に使用されるガラス基板にスクライブラインを形成する場合には適していない。

また、回転可能に支持されたホイールチップをガラス基板の表面に加圧して転動させる方法では、エアシリンダ等の昇降機構を備えて、この昇降機構を用いて基板表面に対してホイールチップを加圧させて、垂直クラックを発生させている。

しかし、このような昇降機構を用いた加圧方式では、昇降機構による押圧力を大きくしなければ、ガラス基板の表面に十分な深さの垂直クラックを容易には形成することが出来ない。また、押圧力を大きくすると、ガラス基板の端部にホイールチップを乗り上げさせる際に、ガラス基板の端部に欠け等の損傷が発生する
15 おそれがあり、また、ガラス基板の平面部においても、ガラス基板を分断した際に、分断面及び分断面を含むガラス基板の端面部に欠けを生じさせる原因となる
20 所望の方向でない方向にクラック（水平クラック）が発生する等の支障が生じるおそれがある。そして、この方法においても、スクライブ時にガラスカレットが発生する。

さらに、ガラス基板に「反り」がある場合には、ホイールチップがこの「反り」に起因する基板表面の凹凸に追従出来ず、ガラス基板の表面に適正な垂直クラックが得られないという問題がある。
25

本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、ガラス基板の端部に欠けが発生する等の支障をきたすことなく、ガラス基板に十分な深さを有する垂直クラックを発生させることができるスクライプライン形成装置及びスクライプライン形成方法を提供することを目的とする。

5

発明の開示

上記課題を解決するため、本発明によれば、先端に刃先を有し、押圧力を付与して刃先を脆性基板の表面に押圧し、スクライプラインの起点となる垂直クラックを形成するための垂直クラック形成部材と、

10 該脆性基板上の所望の位置で、所定の深さの垂直クラックを発生させるために、該垂直クラック形成部材に対して急峻な衝撃力を付与する衝撃力付与手段と、

 該脆性基板の軟化点よりも低い温度の領域を形成する加熱手段と、

 該脆性基板を冷却する冷却手段と、

 該加熱手段、該垂直クラック形成部材、衝撃力付与手段及び該冷却手段を、脆性基板の表面上に予め設定されたスクライプ予定ラインに沿って一定の間隔をあけた状態で、脆性基板に対して相対移動可能に配置された配置移動手段と、

15

 衝撃力付与手段の駆動を制御する制御部とを備えていることを特徴とするスクライプライン形成装置が提供される。

20

 制御部は、刃先が脆性基板表面に損傷を与えない程度の荷重で接触しながら移動されるよう垂直クラック形成部材および配置移動手段の駆動を制御し、刃先が脆性基板の端部近傍および予め形成されたスクライプラインを通過する通過点の近傍に位置するとき、脆性基板上に所定の深さの垂直クラックを発生させるよう衝撃力付与手段の駆動を制御する構成が好ましい。

25

 加熱手段は、脆性基板上を移動する前記垂直クラック形成部材の上下動から該脆性基板表面の高さ変化を検出し、この検出結果に基づいて前記レーザ光発振器から照射されるレーザ光の焦点を調整するためのサーボ機構を具備してなる構成

が好ましい。

冷却手段は、脆性基板上を移動する前記垂直クラック形成部材の上下動に連動して上下動するよう配置移動手段に配置されている構成が好ましい。

配置移動手段が、スクライプ予定ラインの前方側から、垂直クラック形成部材、加熱手段及び冷却手段または、加熱手段、垂直クラック形成部材及び冷却手段のいずれかの順に前記3つの部材を配置してなる構成が好ましい。

配置移動手段が、垂直クラック形成部材、加熱手段及び冷却手段を、互いの相対位置を変更できるように配置してなる構成が好ましい。

冷却手段は、冷却媒体を放出する冷却ノズルであるものが挙げられる。

冷却手段は、冷却手段の高さ位置を調整するサーボ機構を有するものが挙げられる。

垂直クラック形成部材は、ホイールチップを刃先としてこれを転動可能に支持したガラスカッターであるものが挙げられる。

加熱手段は、所定のレーザ光を照射するレーザ光発振器であるものが挙げられる。

衝撃力付与手段は、ソレノイドコイルへの通電をオンまたはオフすることによって、刃先を脆性基板表面上に押圧する移動慣性を発生させるアマチュアーであるものが挙げられる。

脆性基板の表面の高さ変化を検出するためのレーザ変位計または接触式変位計をさらに具備してなるものが挙げられる。

脆性基板は、液晶表示装置用ガラス基板、プラズマディスプレイパネル用ガラス基板および有機ELディスプレイパネル用ガラス基板が挙げられる。

本発明の別の観点によれば、先端に刃先を有する垂直クラック形成部材を脆性基板上を移動させながら刃先に急峻な衝撃力を与える衝撃力付与手段によって、脆性基板上の所望の位置に所定深さの垂直クラックを発生させる工程と、

該垂直クラックに対して、基板上に設定されたスクライプ予定ラインに沿って、

該脆性基板の軟化点よりも低い温度の照射領域を形成すると共に、該照射領域の後方に冷却領域を形成してスクライブラインを形成する工程と、

を包含することを特徴とするスクライブ形成方法が提供される。

5 本発明のスクライブライン形成方法は、刃先が脆性基板の端部近傍および予め形成されたスクライブラインと交差する点の近傍に位置したとき、衝撃力付与手段によって、脆性基板上の所望の位置に所定深さの垂直クラックを発生させる構成が好ましい。

図面の簡単な説明

10 図1は、実施の形態1のスクライブライン形成装置の概略を示す側面図である。

図2は、実施の形態1のスクライブライン形成装置の概略を示す正面図である。

図3(a)～(e)は、それぞれ、実施の形態1のスクライブライン形成装置によってスクライブラインを形成する方法を順番に説明する斜視図である。

図4は、実施の形態2のスクライブライン形成装置の概略を示す側面図である。

15 図5は、実施の形態2のスクライブライン形成装置の概略を示す正面図である。

図6(a)～(e)は、それぞれ、実施の形態2のスクライブライン形成装置によってスクライブラインを形成する方法を順番に説明する斜視図である。

図7は、実施の形態3のスクライブライン形成装置の概略を示す正面図である。

20 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明のスクライブライン形成装置及びスクライブライン形成方法について、図面に基づいて詳細に説明する。

(実施の形態1)

25 図1は、本実施の形態1のスクライブライン形成装置1の概略を示す側面図であり、図2は、図1のI-I線断面からのスクライブライン形成装置1の正面図を示している。

このスクライブライン形成装置 1 は、図 1 及び図 2 に示すように、スクライブラインを形成する脆性材料基板 S を水平状態に固定するテーブル 101 を有している。ここで、本明細書で記載される脆性材料基板 S は、具体的には、マザー基板と呼ばれる大きな寸法の基板を意味している。ガラス製、セラミック製、半導体ウェハーなどの基板があって、それらが順次所定の小さな大きさに分断されて種々の用途に用いられる。脆性材料基板 S が固定されるテーブル 101 の側方の側壁 102 には、水平方向（紙面と鉛直な方向）に沿ったガイドレール 103 が設けられている。このガイドレール 103 には、内部に駆動モータを備えた駆動装置 11 の一端側が接続されている。駆動装置 11 には、駆動モータの駆動によりガイドレール 103 が延びる方向に沿って一定方向にスライド可能になっている。

この駆動装置 11 の他端側には、サーボモータ 2 が設けられている。このサーボモータ 2 は、駆動装置 11 が設けられた側とは反対側に、水平方向に所定長さに突出した回転軸 3 を有している。この回転軸 3 は、サーボモータ 2 により回転駆動されるようになっており、この回転軸 3 の先端部には、回転軸 3 と一体的に回転する支持フレーム 4 が取り付けられている。

サーボモータ 2 の回転軸 3 に取り付けられた支持フレーム 4 は、図 1 に示すように、平坦な板状に形成されたフレーム本体部 4a と、このフレーム本体部 4a の一端側から上方に所定高さに突出する突出部 4b とを有しており、側面視で略 L 字状になるように形成されている。この支持フレーム 4 は、突出部 4b が設けられた一端側を、ガイドレール 103 に沿った進行方向の前方側（図 1 中の左方）に配置して、突出部 4b の上端が、サーボモータ 2 の回転軸 3 に取り付けられている。

支持フレーム 4 におけるフレーム本体部 4a の後方寄りの下面には、ガラスカッター 5 が取り付けられている。ガラスカッター 5 は、超硬合金または焼結ダイヤモンド等の超硬度を有する材質により形成されたホイールチップ 5a と、この

ホイールチップ 5 a を回転可能に支持するホルダ 5 b とを有している。

ガラスカッター 5 は、ホルダ 5 b の上端が、支持フレーム 4 のフレーム本体部 4 a の下面に取り付けられることによって、支持フレーム 4 の移動に伴って一体的に移動するようになっている。ホイールチップ 5 a は、円形状であって幅方向の中央部が最大径になるように突出している。このホイールチップ 5 a は、下面を開放したホルダ 5 b によって、軸心部が回転可能に支持されている。ホイールチップ 5 a は、脆性材料基板 S 上において、垂直クラックを発生させる位置以外でも、常時、脆性材料基板 S の表面上に接触しており、脆性材料基板 S の表面上に対して所定以上の衝撃力が加わるように押圧されると、脆性材料基板 S 上に垂直クラックを発生させる。

支持フレーム 4 のフレーム本体部 4 a の上面のガラスカッター 5 の近傍には、衝撃力付与手段であるアマチュアー 6 が設けられている。このアマチュアー 6 の周囲には、下方に付勢するスプリング（図示せず）が装着されて、アマチュアー 6 は、常時、下方に付勢力が加わった状態になっている。また、アマチュアー 6 の内部には、所定電圧の印加により上方に持ち上げる電磁力を発生するソレノイドコイル 6 a が備えられており、電圧が印加された状態では、ソレノイドコイル 6 a による上方への電磁力と、スプリングによる下方への付勢力とが平衡して、静止した状態になっている。そして、ソレノイドコイル 6 a への電圧の印加、すなわちソレノイドコイル 6 a への電流の供給が停止した場合に、ソレノイドコイル 6 a による上方への電磁力が消失して、スプリングによる下方への付勢力によって、フレーム本体部 4 a の上面に、ガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a を脆性材料基板 S の表面に対して垂直クラックが発生する程度の衝撃力が付与される。そして、再び所定の電圧が印加されると、上方への電磁力が作用して、静止状態に戻るようになっている。

なお、本実施の形態 1 では、電圧の印加が停止した場合に、スプリングの下方への付勢力によって支持フレーム 4 のフレーム本体部 4 a に衝撃力が加えられる

機器構成とした場合について説明したが、逆に、通常の状態では、アマチュアー
6 がスプリングによる上方への付勢力によって静止状態に支持されていて、電圧
が印加（電流が供給）された場合に、下方への電磁力が加わって、フレーム本体
部 4 a に衝撃力が加わる機器構成としてもよい。後者の場合のほうが、電流の印
5 加時間が短いので電力消費が少なくて済む。

支持フレーム 4 のフレーム本体部 4 a の後端部には、冷却媒体を放出するため
の冷却ノズル 7 が、フレーム本体部 4 a と一体的に取り付けられており、支持フ
レーム 4 のフレーム本体部 4 a が脆性材料基板 S 上の凹凸等により上下に移動し
ても、支持フレーム 4 のフレーム本体部 4 a の上下動に追従して移動できるよう
10 になっている。また、この冷却ノズル 7 は、所定の冷却媒体が冷却状態に貯蔵さ
れた図示しない冷却媒体源に接続されている。冷却ノズル 7 から放出される冷却
媒体としては、冷却水、冷却アルコール等の低温液体、または、液状窒素、ドラ
イアイス等を気化させて得られる窒素、二酸化炭素等の低温気体が用いられ、ヘ
リウムやアルゴンなどの不活性ガス、単なるエアなども用いられる。

サーボモータ 2 の後部側には、支持フレーム 4 における本体フレーム 4 a の所
定位置に形成された穴部 4 c を介して脆性材料基板 S の表面上に所定のレーザ光
を照射して、レーザ光が照射された部分を加熱するレーザ光発振器 8 が設けられ
ている。なお、本実施の形態 1 では、レーザ光発振器 8 が発振するレーザ光によ
り脆性材料基板 S の表面に加熱スポットを形成しているが、脆性材料基板 S をス
15 ポットとして加熱できるものであれば、レーザ光の他、赤外線、紫外線等を発生
させる加熱源を用いてもよい。

上述のレーザ光発振器 8、ガラスカッター 5、冷却ノズル 7 は、ガイドレール
1 0 3 に沿った進行方向に沿って、この順に配置されており、レーザ発振器 8 か
ら照射されるレーザ光の照射領域、ガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a が脆
25 性材料基板 S 上に接触する接触領域、冷却ノズル 7 から放出される冷却媒体によ
って冷却される冷却領域が、脆性材料基板 S 上に互いに近接してこの順に形成さ

れるようになっている。

サーボモータ 2 の上部側には、駆動装置 11、レーザ発振器 8、冷却ノズル 7 等の上記各構成の駆動をそれぞれ制御する制御装置 9 が設けられている。この制御装置 9 には、駆動装置 11 によるガイドレール 103 方向に沿った、駆動装置
5 11、レーザ発振器 8 および冷却ノズル 7 の移動の変位量（すなわち、本体フレーム 4 の移動の変位量）を検出すると共に、サーボモータ 2 の回転軸 3 の変位を検出することによって脆性材料基板 S の表面に接触しているガラスカッター 5 のホイールチップ 5a の上下動の変位量を検出するエンコーダが設けられている。

すなわち、スクライブの起点となる垂直クラックを形成するために設置される
10 ガラスカッター 5 のホイールチップ 5a は、脆性材料基板 S 上の垂直クラックを形成しない部分においても、常時、脆性材料基板 S の表面に接触しており、脆性材料基板 S 上に存在する凹凸等によって、脆性材料基板 S の表面に接触するホイールチップ 5a に上下動が生じると、このホイールチップ 5a の上下動に伴って、ホルダ 5b を固定している支持フレーム 4 のフレーム本体部 4b にも上下動が生じ、この支持フレーム 4 のフレーム本体部 4b の上下動が、サーボモータ 2 の回
15 転軸 3 の回転移動を発生させる。制御装置 9 に備えられたエンコーダにより、このサーボモータ 2 の回転軸 3 の回転を検出することによって、ホイールチップ 5a の上下動が検出される。

制御装置 9 は、エンコーダによって、ホイールチップ 5a の変位量から脆性材
20 料基板 S 表面の凹凸を検出することができ、この検出結果に基づいて、レーザ発振器 8 から照射されるレーザ光の焦点形成位置が調整されて、脆性材料基板 S の表面上の凹凸に追従してレーザ光は、そのビーム形状、波長やパルス幅に応じて照射対象物の表面、表面付近又は内部の所定一定深さ位置に焦点が合うように自動制御されて基板上を相対移動させられる。

25 なお、本実施の形態 1 では、冷却ノズル 7 が支持フレーム 4 のフレーム本体部 4a の後端に一体的に取り付けられて、脆性材料基板 S の表面に接触するガラス

カッター 5 の上下動に追従して移動することにより、脆性材料基板 S の表面に対して常に同一の高さから冷却媒体が放出されるようになっているが、上記のレーザ光発振器 8 と同様に、冷却ノズル 7 の高さ位置を、エンコーダによる検出結果に基づいて調整するようにしてもよい。

- 5 次に、本実施の形態 1 のスクライブライン形成装置の動作について、図 3 (a) ~ (e) を参照して説明する。

まず、図 3 (a) に示すように、ホイールチップ 5 a をテーブル後方側に位置する状態として、スクライブラインの形成対象となる脆性材料基板 S をテーブル 101 上の所定位置に固定する。

- 10 次に、駆動装置 11 および制御装置 9 を駆動させて、ホイールチップ 5 a、レーザ発振器 8、冷却ノズル 7 を取り付けした支持フレーム 4 を、脆性材料基板 S の表面上を前方(図 1 の左方)に向けて移動させる。この状態では、ガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a は、その高さ位置がテーブル 101 に載置された脆性材料基板 S に対して、若干下方位置になるように設置されている。また、制御装置 15 9 は、脆性材料基板 S の表面に過度の押圧力が下方に加わらないように、サーボモータ 2 によりガラスカッター 5 を取り付けした支持フレーム 4 にかかるトルクが制御されている。

- 20 駆動装置 11 の駆動により前進したガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a が脆性材料基板 S の端部の位置に到達する。このとき、ガラスカッター 5 には、脆性材料基板 S の表面に垂直クラックを発生させる押圧力が加わらないように制御されているため、脆性材料基板 S の表面より若干下方に設置されたホイールチップ 5 a は、脆性材料基板 S の端部に接触した後、脆性材料基板 S の端部に欠け等を発生させることなく、そのまま脆性材料基板 S の表面上に乗り上がる。この脆性材料基板 S 表面上への乗り上げによって、ガラスカッター 5 に上下動が生じ、
25 この上下動がサーボモータ 2 の回転軸 3 の回転に伝達され、ガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a が脆性材料基板 S の表面に乗り上げられたことが、制御装置

9に備えられたエンコーダによって検出される。

エンコーダによってガラスカッター5のホイールチップ5aが脆性材料基板Sの表面上に乗り上がったことが検出されると、制御装置9は、アマチュアー6のソレノイドコイル6aに印加されている電圧をオフにする。これにより、アマチュアー6は、スプリングの付勢力によって下方に移動し、フレーム本体部4aの上面に衝撃力を付与する。この衝撃力の付与によって、脆性材料基板Sの表面に接触しているガラスカッター5のホイールチップ5aは、脆性材料基板Sの表面上の端部に急峻な衝撃力を与え、脆性材料基板Sの表面上には、図3（b）に示すように、所定深さの垂直クラックTが形成される。次いで、再びソレノイドコイル6aに電圧が印加され、アマチュアー6を上方に押し上げる電磁力が発生して、スプリングの下方への付勢力と上方に押し上げる電磁力とがつりあった状態となって、アマチュアー6は所定高さ位置において静止状態となる。

ガラスカッター5のホイールチップ5aによって脆性材料基板Sの端部にスクライプの起点となる垂直クラックTが形成された後は、制御装置9は、脆性材料基板Sの表面にスクライプが形成されるほどの押圧力が加わらないように、脆性材料基板Sの表面への接触状態を維持する程度の微小な荷重が加えられるように、サーボモータ2を制御する。

脆性材料基板Sの表面に接触しながら転動するホイールチップ5aを有するガラスカッター5は、脆性材料基板Sの表面上に凹凸、反り等があると、脆性材料基板Sに接触するホイールチップ5aに上下動が生じ、このホイールチップ5aの上下動に伴って、ホルダ5bを固定している支持フレーム4にも上下動が生じ、この支持フレーム4の上下動によって、サーボモータ2の回転軸3に回転移動が生じる。制御装置9に備えられるエンコーダでは、このサーボモータ2の回転軸3の回転移動を検出することによって、脆性材料基板S上の凹凸、反り等を検出する。制御装置9は、このようにエンコーダによって検出された脆性材料基板S上の凹凸、反り等に基づいて、レーザ光発振器8の焦点位置の調整を行う。これ

により、脆性材料基板 S 上に凹凸等が生じていても、脆性材料基板 S の表面上又は内部の一定深さ位置に焦点が合った状態でレーザ光が照射される。また、冷却媒体を供給する冷却ノズル 7 は、支持フレーム 4 のフレーム本体部 4 b の後端部に一体的に取り付けられているので、脆性材料基板 S の表面の凹凸によって上下
5 動するホイールチップ 5 a の動きに連動して、上下動するようになっており、冷却ノズル 7 は、脆性材料基板 S に対して、冷却ノズル 7 の先端と脆性材料基板 S との間の距離が一定に保たれるようになっており、脆性材料基板 S に凹凸等があっても、常に適正に冷却媒体を供給できる位置とされる。

引き続き、駆動装置 11 および制御装置 9 の駆動によって、図 3 (c) に示すように、レーザ光発振器 8、ホイールチップ 5 a、冷却ノズル 7 のそれぞれが脆性材料基板 S の表面上を一定方向に移動する。このとき、走査方向の前方側では、レーザ光発振器 8 によって照射されたレーザ光により、脆性材料基板 S の表面が熔融されない温度、すなわち、ガラス軟化点よりも低い温度に加熱される。
10 これにより、レーザ光が照射される照射領域 L では、脆性材料基板 S の表面が熔融
15 されることなく加熱される。

また、脆性材料基板 S の表面におけるレーザ光の照射領域 L の近傍となる後方側には、冷却ノズル 7 から冷却媒体が放出されて、冷却領域 C が形成されている。レーザ光が照射されて加熱されるレーザ光照射領域 L の脆性材料基板 S の表面には、レーザ光による加熱によって圧縮応力が生じ、冷却媒体が放出される冷却領域 C には、冷却媒体によるガラス表面の冷却により引張り応力が生じる。このように、圧縮応力が生じたレーザ光照射領域 L に近接して引張り応力が生じるために、両領域間に、それぞれの応力に基づく応力勾配が発生し、脆性材料基板 S には、脆性材料基板 S の端部に形成された垂直クラック T を起点として、スクライ
20 ブ予定ラインに沿って、ほぼ垂直クラック T の深さで、この垂直クラックが伸展
25 していく。このように、順次、レーザ光発振器 8、冷却ノズル 7 が一定方向に走査されることによって、走査方向に沿ったスクライブラインが形成される。

脆性材料基板 S の端部においてガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a によって形成された垂直クラック T を起点として、レーザ光が照射されるレーザ光照射領域 L と冷却媒体が放出される冷却領域 C との応力勾配を利用したスクライブラインの形成は、図 3 (d) に示すように、レーザ光照射領域 L と冷却領域 C との間に、走査方向に交差するスクライブライン S L C が既に形成されている場合には、応力勾配が交差するスクライブライン S L C の部分で途切れた状態となっており、交差するスクライブライン S L C を超えて、スクライブラインを形成することができない場合がある。そこで、本実施の形態 1 のスクライブライン形成装置では、制御装置 9 に備えられたエンコーダによって、駆動装置 11 によるガイドレール 103 に沿った本体フレーム 4 の移動距離が検出されており、制御装置 9 が、交差するスクライブライン S L C が形成された位置を記憶することによって、ガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a が交差するスクライブライン S L C を超えた位置に到達する直前に、アマチュア 6 のソレノイドコイル 6 a への電圧印加（電流の供給）が停止される。この電圧のオフは、交差するスクライブライン S L C に到達するのと同時ではなく、ソレノイドコイル 6 a のインダクタンス成分による電氣的過渡遅れによる時間分とホイールチップ 5 a が該交差位置 Z の真上で所定の高さ位置迄上昇するだけの機械的慣性分の移動時間遅れ分を合計した時間分だけ早めに電圧がオフにされる。その時間分は、コイルの電氣的特性値と流す電流値（必要なトルク値）とホイールチップ 5 a の基板に対する相対移動速度から求めることができる。そうして求めた時間遅れ分の値を予め制御装置 9 に記憶させておき、スクライブライン条件が新たに設定されたり変更されたりする度に、対応する遅れ時間の値を記憶領域から読み出して使用する。そうした遅れ時間に相当する時間分だけ早めにソレノイドコイル 6 a への通電を停止させることにより、アマチュア 6 は、スプリングの付勢力によって下方に移動し、支持フレーム 4 の上面に衝撃力を付与する。この衝撃力の付与によって、脆性材料基板 S の表面上の端部および図 3 (e) に示した、該交差位置 Z の近傍には急峻な衝撃力が与

えられ、脆性材料基板 S の表面上の交差するスクライプライン S L C を超えた位置に、スクライプライン形成の起点となる所定深さの垂直クラック T が形成される。

5 これにより、スクライプライン S L を形成する途上に、走査方向に交差するスクライプライン S L C が形成されていても、垂直クラック T に連続したスクライプライン S L を確実に形成することができる。

10 以上説明したように、本実施の形態 1 のスクライプライン形成装置 1 は、ガラスカッター 5 の上方側に配置されたアマチュアー 6 からの衝撃力によって脆性材料基板 S の表面上に垂直クラック T を発生させるため、脆性材料基板 S の表面上の所望の位置にのみ急峻な衝撃力を発生させて、高精細に分断するために十分な深さの垂直クラック T を発生させることができる。

 アマチュアー 6 からの衝撃力は、前記従来の昇降装置による加圧力に比べると極端に小さい力ですむので、装置の簡略化、小型化を図れる。

15 アマチュアー 6 から衝撃力が与えられない場合に、ガラスカッター 5 は、脆性材料基板 S の表面に必要最小限のスクライプ圧で接触してスクライプ動作を実行するので、ガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a が脆性材料基板 S に乗り上がる際に脆性材料基板 S の端部に欠け等が発生することを防止することができる。

20 また、脆性材料基板 S の表面に接触しているガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a は脆性材料基板 S の表面上の凹凸等に対応して上下動を生じ、この上下動をサーボモータ 2 の回転軸 3 の回転からエンコーダが検出し、この検出結果に基づいて、レーザ発振器 8 の焦点位置を調整することができるので、脆性材料基板 S に凹凸等があっても、脆性材料基板 S の表面上又は所定深さの一定位置にレーザ光が適切に照射され、高精細なスクライプラインを表面又は内部に形成することができる。

25 さらに、ガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a によりスクライプラインの起点となる垂直クラック T を形成し、この垂直クラック T をスクライプ予定ライン

に沿って伸展させる手段として、脆性材料基板 S にレーザ光による加熱と冷却媒体による冷却による温度勾配を形成し、形成された温度勾配に基づく脆性材料基板 S の熱歪みを利用しているため、カレットは起点付近にごくわずかに発生するのみとなり、従来の刃先を用いた方法と比較すると発生するカレットの量は激減する。

制御装置 9 は、ホイールチップ 5 a が脆性基板表面に損傷を与えない程度の荷重で接触しながら移動されるよう駆動装置 11 の駆動を制御し、ホイールチップ 5 a が脆性基板 S の端部近傍および予め形成されたスクライブライン S L C の交差位置 Z の近傍に位置するとき、脆性基板上に所定の深さの垂直クラックを発生させるようアマチュア 6 の駆動を制御するので、高精緻なスクライブライン S L を形成することができる。

(実施の形態 2)

図 4 は、本実施の形態 2 のスクライブライン形成装置 1' の概略を示す側面図であり、図 5 は、図 4 の IV—IV 線断面からのスクライブライン形成装置 1' の正面図を示している。

本実施の形態 2 のスクライブライン形成装置 1' は、図 4 に示すように、レーザ発振器 8 が、ガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a が脆性材料基板 S の表面に接触する部分より後方側にレーザ光を照射するように、制御装置 9 から後方側（図中右方）に延びた位置に設けられている。

他の構成は、前述の実施の形態 1 のスクライブ形成装置 1 と同様となっているので、詳しい説明は省略する。

このスクライブライン形成装置 1' では、ホイールチップ 5 a、レーザ発振器 8、冷却ノズル 7 が、ガイドレール 103 に沿った進行方向に沿って、この順に配置されており、ガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a が脆性材料基板 S 上に接触する接触領域、レーザ発振器 8 から照射されるレーザ光の照射領域、冷却ノズル 7 から放出される冷却媒体によって冷却される冷却領域が、脆性材料基板 S

上に互いに近接して形成されるようになっている。

本実施の形態 2 のスクライブライン形成装置 1' では、脆性材料基板 S の表面に接触した状態で移動するガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a の上下動を、サーボモータ 2 の回転軸 3 の回転に基づいて、制御装置 9 に設けたエンコーダによって検出する。そして、この検出結果に基づいて、ガラスカッター 5 の後方側に配置されたレーザ発振器 8 のレーザ照射位置を調整する。

なお、本実施の形態 2 のスクライブライン形成装置 1' の動作についても、前述の実施の形態 1 のスクライブライン形成装置 1 の動作と概略同一であり、この実施の形態 2 のスクライブライン形成装置 1' の動作について説明する図 6

(a) ~ (e) を参照するとして、詳しい説明は省略する。

本実施の形態 2 のスクライブライン形成装置 1' では、ガラスカッター 5 の上方側に配置されたアマチュアー 6 からの衝撃力によって脆性材料基板 S の表面上に垂直クラック T を発生させるため、脆性材料基板 S の表面上の所望の位置にのみ急峻な衝撃力を発生させて、高精細に分断するために十分な深さの垂直クラック T を発生させることができ、アマチュアー 6 から衝撃力が与えられない場合には、ガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a は、脆性材料基板 S の表面に接触して所定のスクライブを発生させる軽度の荷重しか加えられていないので、ガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a が脆性材料基板 S に乗り上がる際に脆性材料基板 S の端部に欠け等が発生することを防止することができる。

また、脆性材料基板 S の表面上の凹凸等が、脆性材料基板 S の表面に接触しているガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a の上下動をサーボモータ 2 の回転軸 3 の回転からエンコーダが検出し、この検出結果に基づいて、レーザ発振器 8 の焦点位置を脆性材料基板 S に存在する凹凸に追従して調整することができるので、脆性材料基板 S の凹凸等があっても、脆性材料基板 S の表面上又は所定の深さの位置にレーザ光が適切に照射され、高精細なスクライブラインを形成することができる。

(実施の形態 3)

図 7 は、本実施の形態 3 のスクライブライン形成装置 1” の概略を示す側面図である。

5 本実施の形態 3 は、支持フレーム 4 の本体フレーム 4 a の下面において、ガラスカッター 5 の前方になる位置に、脆性材料基板 S の凹凸、反り等の変動をレーザ光の照射によって検出するレーザ変位計 10 が設けられている。他の構成は、前述の実施形態 1 のスクライブライン形成装置 1 と同様であり、詳しい説明は省略する。

10 また、本実施の形態 3 のスクライブライン形成装置 1” の動作についても、脆性材料基板 S の表面の凹凸をレーザ変位計 10 を用いて検出する点以外は、前述の実施の形態 1 のスクライブライン形成装置の動作と概略同一であり、詳しい説明は省略する。

15 本実施の形態 3 のスクライブライン形成装置 1” は、ガラスカッター 5 の上方側に配置されたアマチュアー 6 からの衝撃力によって脆性材料基板 S の表面上に垂直クラックを発生させるため、脆性材料基板 S の表面上の所望の位置にのみ急峻な衝撃力を発生させて、高精細に分断するために十分な深さの垂直クラック T を発生させることができ、アマチュアー 6 から衝撃力が与えられない場合には、ガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a は、脆性材料基板 S の表面に接触して所定のスクライブを発生させる軽度の荷重しか加えられていないので、ガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a が脆性材料基板 S に乗り上がる際に脆性材料基板 S の端部に欠け等が発生することを防止することができる。

25 また、脆性材料基板 S の表面上の凹凸等が、脆性材料基板 S の表面に接触しているガラスカッター 5 の前方側に設けられたレーザ変位計 10 によって検出され、この検出結果に基づいて、レーザ発振器 8 の焦点位置を脆性材料基板 S に存在する凹凸に追従して調整することができるので、脆性材料基板 S に凹凸等があっても、脆性材料基板 S の表面上又は内部の一定深さ位置に常に焦点が合った状態で

照射され、高精細なスクライブを形成することができる。

なお、脆性材料基板 S の表面上の凹凸等は、上記のレーザ変位計 10 のほかに、接触式変位計を設けることによっても検出することができる。

上記の実施の形態 1～3 でそれぞれ説明したスクライブライン形成装置は、ガラスカッター 5、冷却ノズル 7 およびレーザ光発振器 8 を固定して配置したが、スクライブライン形成条件に応じ、これらを互いの相対位置を変更できるように公知の技術を用いて支持フレーム 4 上に配置する構成としてもよい。これにより、スクライブライン形成条件に応じた適正なスクライブラインを形成することができる。なお、スクライブライン形成における諸条件とこれらの互いの相対位置との関係は日本国特許第 3027768 号の公報を参照されたい。

上記の実施の形態 1～3 でそれぞれ説明したスクライブライン形成装置は、脆性材料基板 S にスクライブラインの起点となる垂直クラック T を発生させるガラスカッター 5 のホイールチップ 5a を、脆性材料基板 S の表面上の凹凸、反りを検出するようにしたので、装置構成を安価でコンパクトなものとすることができる。

本発明の特徴の一つとして、基板 S の端部または交差位置 Z を予めレーザ光によって加熱後、スクライブラインの起点となる垂直クラック T を形成させる事が可能なので、基板 S の端部または交差位置 Z における制御不能なクラックの発生を抑えることができる。

垂直クラック T の形成を進行方向において、端部をわずかに越えた基板内の位置で行い（内切りの開始）あるいはスクライブラインの形成を進行方向末端のわずか手前で終了する（内切りの終了）様に制御装置 9 を駆動することにより、上記の制御不能なクラックの発生を抑えることができる。

25 産業上の利用可能性

以上説明したように、本発明は、ガラスカッターのホイールチップを、脆性基

板の表面上に損傷を与えない程度の荷重で接触しながら移動させ、この脆性基板上を移動するガラスカッターに対して所定深さの垂直クラックを発生させる急俊な衝撃力を与える衝撃力付与手段によって、脆性基板上の所望の位置に垂直クラックを発生させる。そして、形成された垂直クラックに対して、スクライプ予定ラインに沿って、脆性基板の軟化点よりも低い温度の照射領域が形成されるレーザ光を照射するレーザ光発振器と、脆性基板を冷却するための冷却媒体を放出する冷却ノズルとを配置し、脆性基板上におけるレーザ光発振器からレーザ光が照射される照射領域に生じる圧縮応力と該冷却ノズルから放出される冷却領域に生じる引張応力とにより発生する応力勾配によって、ガラスカッターによって形成された垂直クラックが、スクライプ予定ラインに沿って伸展させることによってスクライプラインを形成する。

したがって、本発明では、脆性基板の表面上に垂直クラックを発生させる所望の位置以外では、脆性基板に接触する程度の荷重がかかっており、過度の押圧力が脆性基板に付加することがないので、ガラスカッターのホイールチップが脆性基板上に乗り上がる場合等に脆性基板に欠け等の損傷を生じることを防止することができる。

また、脆性基板の表面に凹凸があったり、脆性基板に反りがある場合でも、脆性基板表面の高さに応じた適正なスクライプ条件を採り得るので、常に安定したスクライプラインを形成することができる。

さらに、スクライプラインの起点となる垂直クラックを刃先で形成する以外は、その垂直クラックを脆性基板に生じる熱歪みを利用してスクライプ予定ラインに沿って伸展させてスクライプラインを形成するため、カレットは起点付近にごくわずかに発生するのみとなり、従来の刃先を用いた方法と比較すると激減する。

請求の範囲

1. 先端に刃先を有し、押圧力を付与して刃先を脆性基板の表面に押圧し、スクライブラインの起点となる垂直クラックを形成するための垂直クラック形成部材と、

該脆性基板上の所望の位置で、所定の深さの垂直クラックを発生させるために、該垂直クラック形成部材に対して急峻な衝撃力を付与する衝撃力付与手段と、

該脆性基板の軟化点よりも低い温度の領域を形成する加熱手段と、

該脆性基板を冷却する冷却手段と、

該加熱手段、該垂直クラック形成部材、衝撃力付与手段及び該冷却手段を、脆性基板の表面上に予め設定されたスクライプ予定ラインに沿って一定の間隔をあけた状態で、脆性基板に対して相対移動可能に配置された配置移動手段と、

衝撃力付与手段の駆動を制御する制御部とを備えたスクライプライン形成装置。

2. 制御部は、刃先が脆性基板表面に損傷を与えない程度の荷重で接触しながら移動されるよう垂直クラック形成部材および配置移動手段の駆動を制御し、刃先が脆性基板の端部近傍および予め形成されたスクライプラインを通過する通過点の近傍に位置するとき、脆性基板上に所定の深さの垂直クラックを発生させるよう衝撃力付与手段の駆動を制御する請求の範囲第1項に記載のスクライプライン形成装置。

3. 加熱手段は、脆性基板上を移動する前記垂直クラック形成部材の上下動から該脆性基板表面の高さ変化を検出し、この検出結果に基づいて前記レーザ光発振器から照射されるレーザ光の焦点を調整するためのサーボ機構を具備してなる請求の範囲第1項に記載のスクライプライン形成装置。

4. 冷却手段は、脆性基板上を移動する前記垂直クラック形成部材の上下動に連動して上下動するよう配置移動手段に配置された請求の範囲第1項に記載のスクライプライン形成装置。

5. 配置移動手段が、スクライプ予定ラインの前方側から、垂直クラック形成部材、加熱手段及び冷却手段または、加熱手段、垂直クラック形成部材及び冷却手段のいずれかの順に前記3つの部材を配置してなる請求の範囲第1項に記載のスクライプライン形成装置。

5 6. 配置移動手段が、垂直クラック形成部材、加熱手段及び冷却手段を、互いの相対位置を変更できるように配置してなる請求の範囲第1項に記載のスクライプライン形成装置。

7. 冷却手段は、冷却手段の高さ位置を調整するサーボ機構を有する請求の範囲第1項に記載のスクライプライン形成装置。

10 8. 垂直クラック形成部材は、ホイールチップを刃先としてこれを転動可能に支持したガラスカッターである請求の範囲第1項に記載のスクライプライン形成装置。

9. 加熱手段が、所定のレーザー光を照射するレーザー光発振器である、請求の範囲第1項に記載のスクライプライン形成装置。

15 10. 冷却手段が、冷却媒体を放出する冷却ノズルである、請求の範囲第1項に記載のスクライプライン形成装置。

11. 衝撃力付与手段は、ソレノイドコイルへの通電をオンまたはオフすることによって、刃先を脆性基板表面上に押圧する移動慣性を発生させるアマチュアーである、請求の範囲第1項に記載のスクライプライン形成装置。

20 12. 脆性基板の表面の高さ変化を検出するためのレーザー変位計および接触式変位計のいずれか1つをさらに具備してなる請求の範囲第1項～第11項のいずれか1つに記載のスクライプライン形成装置。

13. 脆性基板が、液晶表示装置用ガラス基板、プラズマディスプレイパネル用ガラス基板および有機ELディスプレイパネル用ガラス基板の中から選択された

25 1つである請求の範囲第1項～第12項のいずれか1つに記載のスクライプライン形成装置。

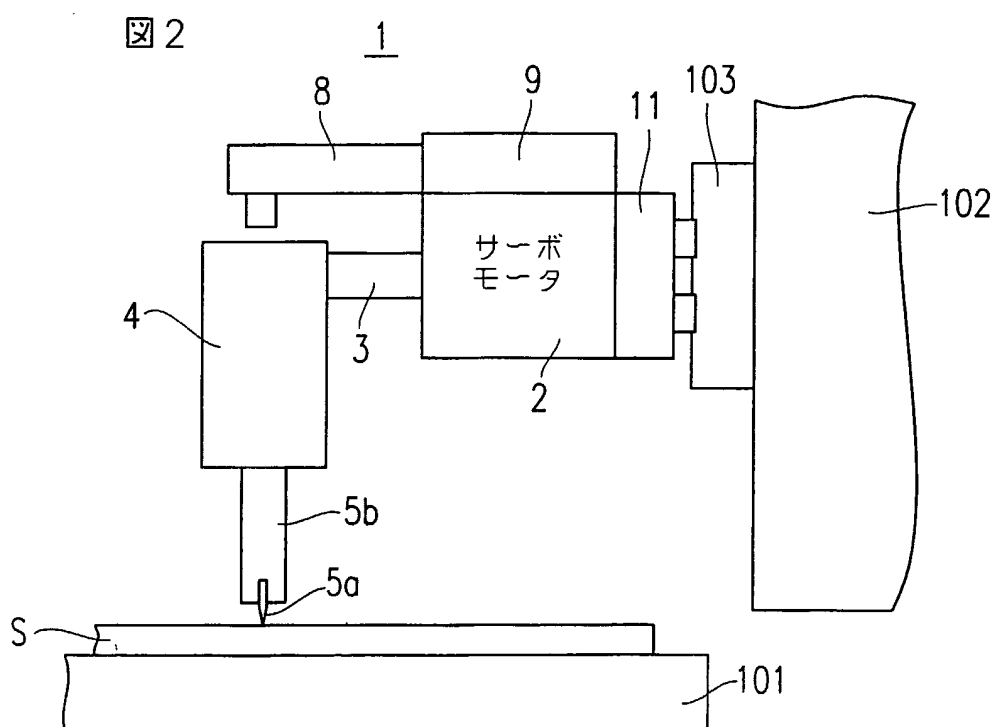
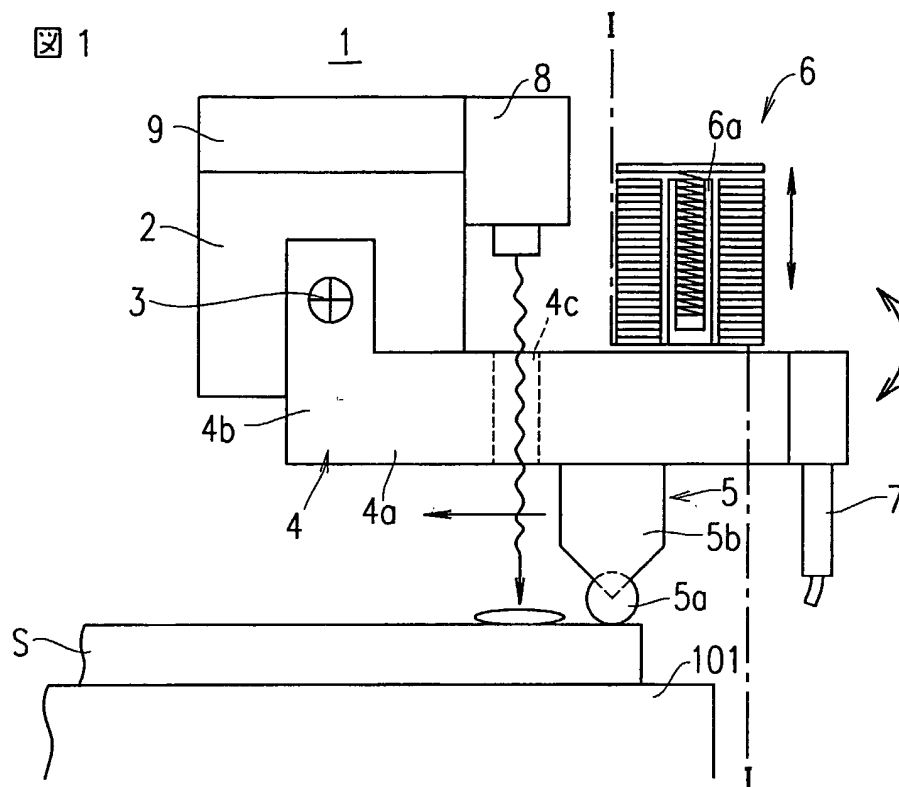
1 4. 先端に刃先を有する垂直クラック形成部材を脆性基板上を移動させながら刃先に急俊な衝撃力を与える衝撃力付与手段によって、脆性基板上の所望の位置に所定深さの垂直クラックを発生させる工程と、

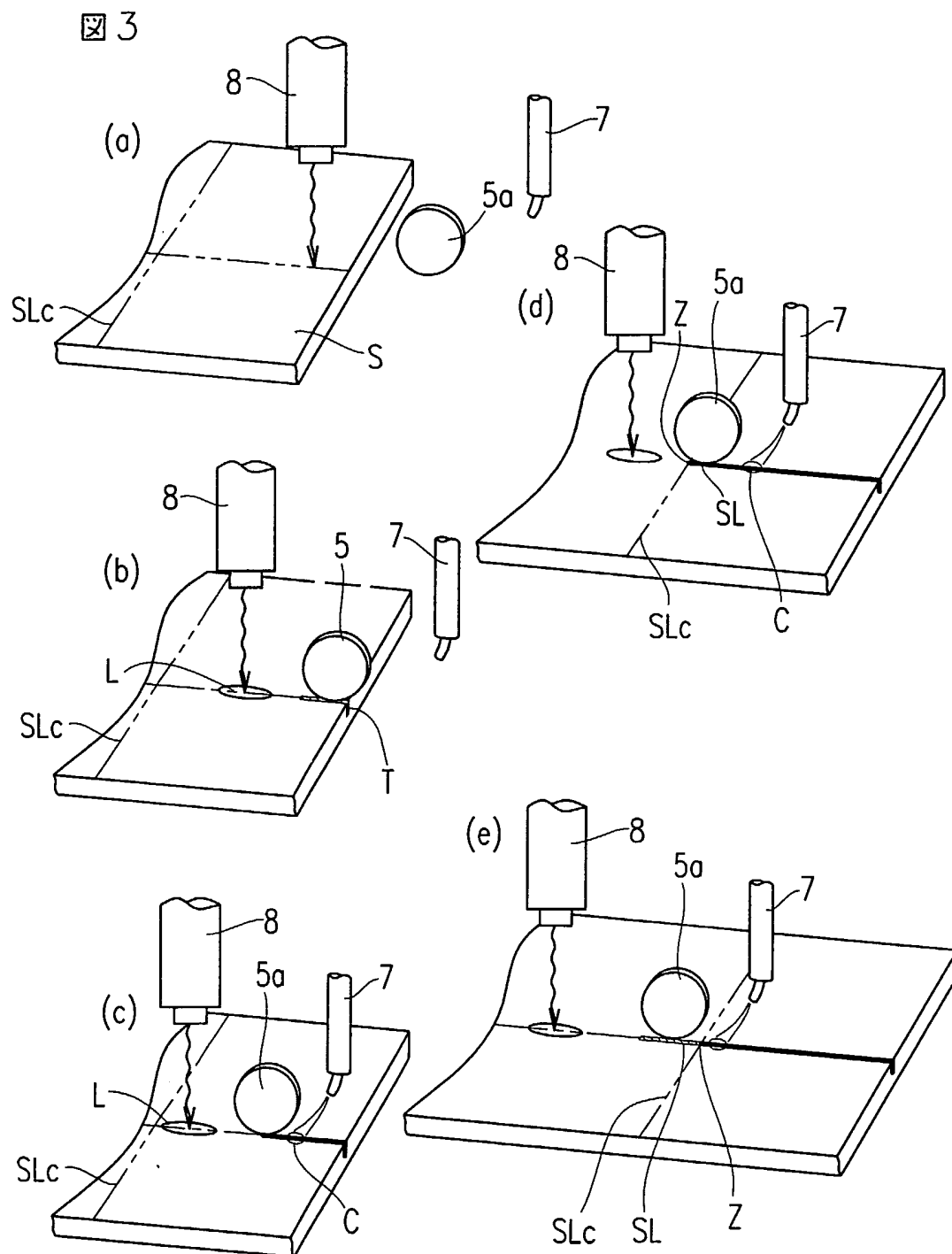
5 該垂直クラックに対して、基板上に設定されたスクライプ予定ラインに沿って、該脆性基板の軟化点よりも低い温度の照射領域を形成すると共に、該照射領域の後方に冷却領域を形成してスクライプラインを形成する工程と、

を包含することを特徴とするスクライプ形成方法。

1 5. 刃先が脆性基板の端部近傍および予め形成されたスクライプラインと交差する交差位置の近傍に位置するとき、衝撃力付与手段によって、脆性基板上の所望の位置に所定深さの垂直クラックを発生させる請求の範囲第 1 4 項に記載のスクライプライン形成方法。

10





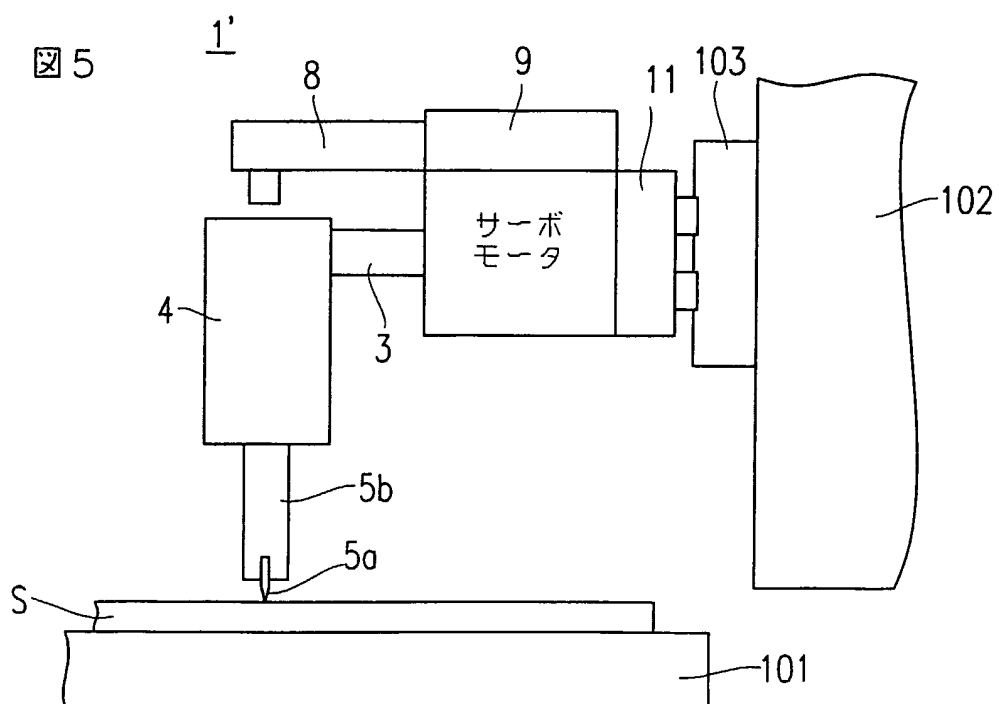
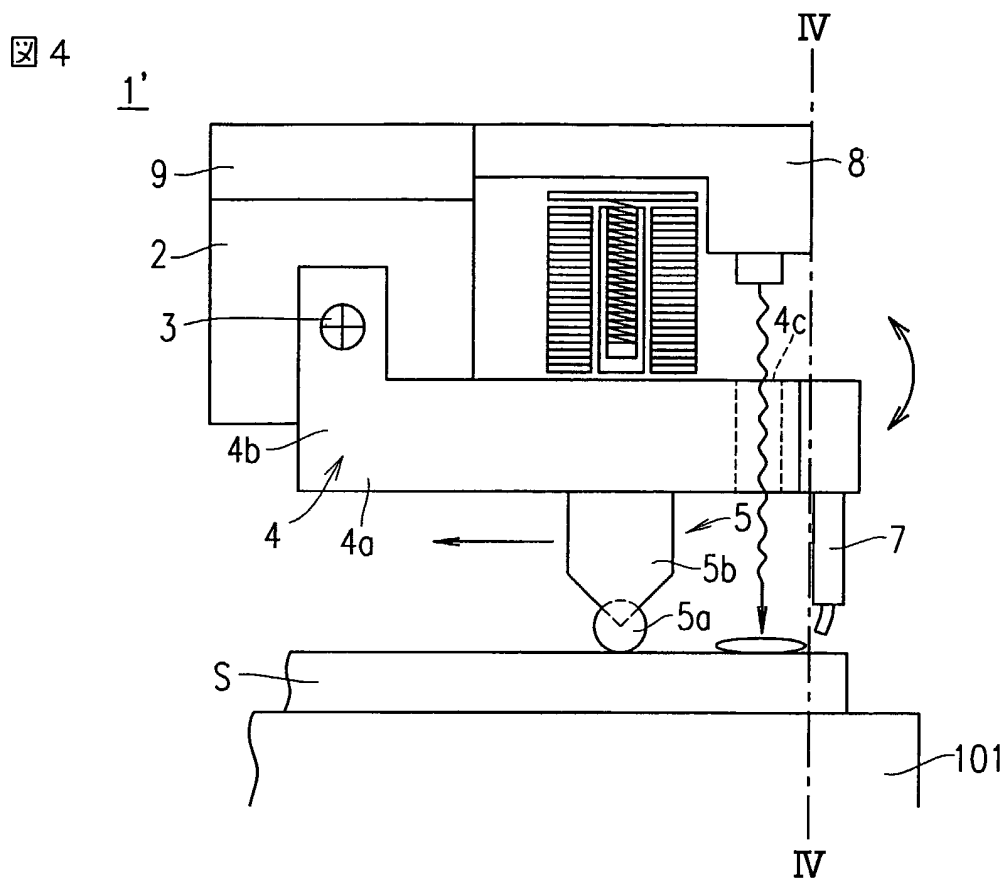
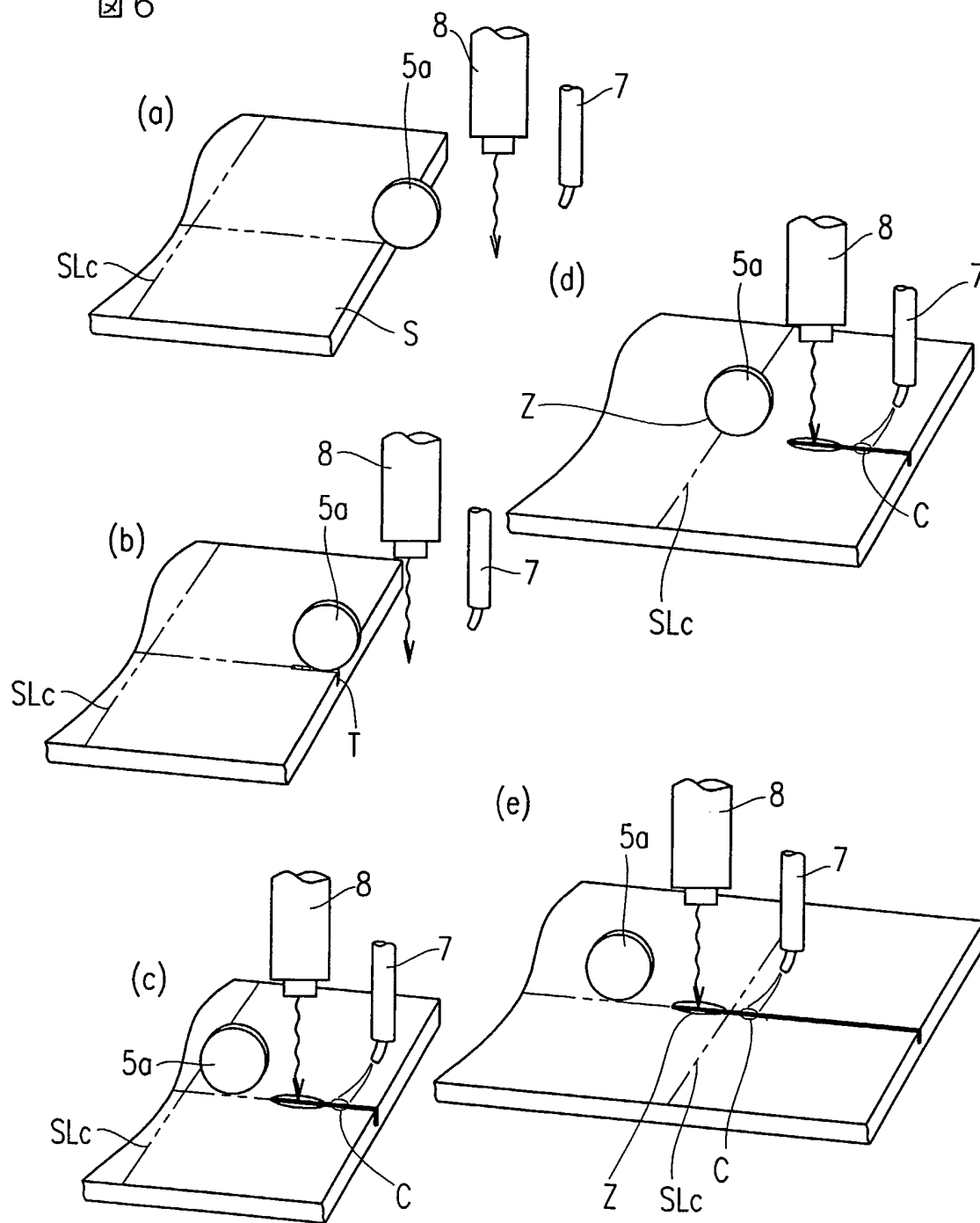


図 6



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/14080

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ B28D5/00, C03B33/03, C03B33/023

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ B28D5/00-5/04, C03B33/00-33/14

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2000-63137 A (Toyota Motor Corp.), 29 February, 2000 (29.02.00), Claims 1, 2; Fig. 1 (Family: none)	1-15
A	JP 2002-308637 A (Sony Corp.), 23 October, 2002 (23.10.02), Par. Nos. [0051] to [0054]; Figs. 10 to 15 (Family: none)	1-15
A	JP 2001-151525 A (Mitsuboshi Diamond Kogyo Kabushiki Kaisha), 05 June, 2001 (05.06.01), Claim 2; Figs. 12, 13 (Family: none)	1-15

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
03 February, 2004 (03.02.04)

Date of mailing of the international search report
17 February, 2004 (17.02.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/14080

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2000-61676 A (Asahi Glass Co., Ltd.), 29 February, 2000 (29.02.00), Claim 1; Fig. 1 (Family: none)	1-15
A	JP 2001-58317 A (Kabushiki Kaisha Berudekkusu), 06 March, 2001 (06.03.01), Claim 1; Fig. 1 (Family: none)	1-15

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl ⁷ B28D5/00, C03B33/03, C03B33/023			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl ⁷ B28D5/00-5/04, C03B33/00-33/14			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年			
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
A	J P 2000-63137 A (トヨタ自動車株式会社) 2000.02.29, 請求項1, 請求項2, 図1 (ファミリーなし)	1-15	
A	J P 2002-308637 A (ソニー株式会社) 2002.10.23, 【0051】-【0054】, 図10-15 (ファミリーなし)	1-15	
A	J P 2001-151525 A (三星ダイヤモンド工業株式会社) 2001.06.05, 請求項2, 図12, 図13 (ファミリーなし)	1-15	
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー		の日の後に公表された文献	
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの		「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの	
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの		「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの	
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)		「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの	
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		「&」同一パテントファミリー文献	
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願			
国際調査を完了した日 03.02.2004		国際調査報告の発送日 17.2.2004	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 紀本 孝	3 P 8815
		電話番号 03-3581-1101 内線 3363	

C (続き). 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	J P 2000-61676 A (旭硝子株式会社) 2000. 0 2. 29, 請求項1, 図1 (ファミリーなし)	1-15
A	J P 2001-58317 A (株式会社ベルデックス) 200 1. 03. 06, 請求項1, 図1 (ファミリーなし)	1-15